

**岗位名称：嵌入式系统开发工程师****岗位职责：**

1. 负责公司研发项目系统方案设计，硬件选型，原理图与 PCB 设计，软件开发调试，系统性能测试等研发相关工作。
2. 负责具体项目的客户日常沟通与协调，配合客户解决实际问题，对超出自身知识能力范围的，积极学习探索，突破研发瓶颈。
3. 对新器件、新技术、新工艺持续跟踪，优先选择新器件及新工艺提升产品性能。
4. 负责相关产品在 PCB 及 PCBA 生产过程中的技术指导及工艺工程辅助，包括但不限于 PCB 设计，生产制造，元器件采购技术问题，器件质量检验及管理方法，生产过程中的工艺问题管理，测试方法及技术相关售后事宜管理。

任职基本要求：

1. 本科以上学历，良好的英文听说读写能力，4 年以上研发工作经验。
2. 独立的软硬件开发经验。熟悉元器件的相关参数、PCB、PCBA 相关知识及生产工艺流程。
3. 熟练使用 Cadence (AD 也可) 软件进行原理图及 PCB 设计 (4 层以上)。
4. 具备一定的模拟电路设计能力，特别是 DC/DC 电源设计调试能力。
5. SMT32 或同级别单片机/ ARM 处理器软硬件开发经验，熟练编写和调试嵌入式软硬件系统。
6. 熟悉 Ethernet, IIC, SPI, 485, 422, Can, USB, TYPE-C, Lin 接口中至少 2 种接口软硬件设计经验。
7. 熟悉 WIFI, 蓝牙, ZigBee, Lora, NB-IOT, 4G/5G 无线通信单元中，至少 1 种功能的软硬件设计。(不强制要求)
8. 对待人和事，简单直接透明，有大局观，有责任心、亲和力、具备良好的应变能力和承压能力，综合素质好。
9. 良好的适应性及学习能力，很好的执行力。
10. 较强的沟通能力及协作精神，分析判断和协调能力，良好的自我管理能力。

11. 普通话标准流利，语言表达能力强，口齿清楚，思维敏捷，做事有规范，流程和标准。

优先考虑条件：

1. 通晓基本要求中更多的有线通讯和无线通信协议软硬件设计。
2. 有电源，运放，ADC 采样等模拟电路软硬件开发设计能力。对模拟电路的设计与开发，有实战经验。
3. 丰富的 FPGA 软硬件设计实战经验。
4. 丰富的 DSP 软硬件设计实战经验。
5. 摄像头及图像传输软硬件开发设计实战经验。
6. LCD 显示屏及触摸控制系统设计实战经验。
7. PC 端监控或通信软件设计开发能力。
8. 有物联网及云服务及 APP 系统开发实战经验。
9. 有芯片 IC 验证和测试经验的优先考虑。

薪资：16K-22K + 项目奖金 + 季度部门盈利奖金